

<新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業（2026年度）>

高耐熱ボアホールスキャナーと坑内3次元モデル化技術を用いた地熱井状態診断高度化による発電コスト低減のための研究開発

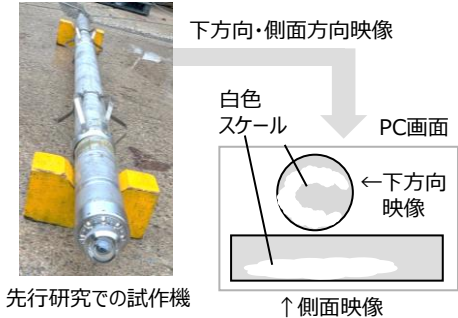
1. 事業概要（地熱エネルギー分野）

〔内容〕
地熱井の坑内状況の詳細把握を目的とし、「高耐熱カメラ検層器（ボアホールスキャナー）」および坑内状況（付着スケールの厚さ等）を定量的に把握可能とする3Dモデル化技術を開発する。ボアホールスキャナーは耐熱200℃、耐圧25MPa、測定深度約2,500mとする。
〔背景・経緯〕

坑内トラブルは特に高温・大深度域で発生しやすいが、そのような条件下で坑内下方向・側面方向を同時にカラー撮影可能なカメラ検層器は実用化されておらず、開発が望まれている。
〔狙い、波及効果〕

坑内トラブルの詳細把握が可能となり、それをもとに適切な対策が早期に実施されることで、発電出力の回復・発電原価低減につながる。

〔事業化〕
「坑内カメラ検層サービス」として、測定・3Dモデル化等による坑内状況の推定・トラブルへの対策提案を行う。



2. 地熱エンジニアリング株式会社

本社所在地	岩手県滝沢市大釜大清水 356番地6
設立／資本金	1976年／80百万円
従業員数	85名（2026年5月現在）
事業内容	地熱坑井，観測井，温泉井等の坑井の掘削請負，地熱資源探査の請負およびコンサルタント

3. その他機関

三井金属資源開発株式会社
（共同提案者）
・「坑内映像の3Dモデル化」技術開発を担当。